산업통상자원부	보 도 참 고 자 료		http://www.motie.go.kr
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.			
배포일시	2018. 4. 17. (화)	담당부서	전자부품과
담당과장	박영삼 과장 (044-203-4270)	담 당 자	이태욱 사무관(044-203-4275)

작업환경보측정보고서, 국가핵심기술 포함 판정

▶ 반도체전문위 4.16~17 양일간 국가핵심기술 포함여부 검토

▶ '09~'17년사이 화성, 기흥, 평택 및 온양 공장 보고서의 일부 국가핵심기술 포함 판정

□ 산업통상자원부는 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」(이하 '산업기술보호법')에 따라 4. 16. ~ 17. 이틀간 **산업기술보호 반도체전문위원회**를 개최하고 삼성전자가 신청한 반도체 공장의 작업환경측정 결과보고서에 대해 검토한 결과 일부 내용이 국가핵심기술을 포함한 것으로 최종 판정했다.

□ 신청인은 **산업기술보호법 제9조제6항에 따라 산업기술 정보에 해당하는 작업환경측정결과보고서** 국가핵심기술 포함 여부를 판정을 요청했다.

○ 전문위원회는 위원회 전체의견으로 신청인의 반도체 공장 작업환경측정결과보고서의 일부 내용이 **국가핵심기술에 해당한다고 검토·결정**했다.

□ 이번 국가핵심기술 판정 대상인 작업환경측정결과보고서는 산업안전보건법 제42조에 따라 작업장의 작업환경을 측정한 자료로써, 신청인의 '09~'17년 화성, 기흥, 평택, 온양 사업장의 작업환경측정결과보고서에 국가핵심기술로 지정한 "30nm 이하급 디램(DRAM), 낸드플래시(NAND Flash), 무선공유가(AP)의 공정 및 조립기술"이 포함된 것으로 판정했다.

○ 특히, 작업환경측정결과보고서에 포함한 단위작업장소별 화학물질(상품명), 측정순서, Layout, 월 취급량 등의 정보로부터 공정과 조립기술의 유추가 가능하다고 판단했다. 끝.

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 전자부품과 이태욱 사무관(☎ 044-203-4275)에게 연락주시기 바랍니다.

[참고1] 반도체 국가핵심기술별 해당 보고서

구분	국가핵심기술명	해당 보고서(사업장별.연도별)
1	30나노 이하급 D램에 해당되는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술	- 화성(`10~`17) ※ 공정기술에 해당
2	30나노 이하급 D램에 해당되는 조립·검사기술	- 온양(`11~) ※ 조립기술에 해당
3	30나노 이하급 낸드플래시에 해당되는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술	- 화성(`09~`17) - 평택(`17) ※ 공정기술에 해당
4	30나노 이하급 낸드플래시에 해당되는 조립·검사기술	- 온양(`10~`17) ※ 조립기술에 해당
5	30나노 이하급 파운드리에 해당되는 공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술	- 화성(`09~`17) - 기흥(`09~`17) ※ 공정기술에 해당
6	모바일 Application Processor SoC 설계·공정 기술	- 기흥(`09~`17) ※ 공정기술에 해당
7	LTE/LTE_adv Baseband Modem 설계기술	해당없음

[참고2] 보고서 세부 내용별 국가핵심기술 해당사유

구분	주요내용	해당 사유
1. 측정위치도	공정명, 공정 lay-out	- 최적의 공정배치 방법을 포함하고 있어, 유출시 경쟁업체의 생산성 개선에 활용가능
2. 화학물질	공정별 화학물질명(상품명), 월 취급량	- 특정 라인·공정에서 사용되는 화학물질명(상품명), 월 취급량 등을 통해 공정 노하우 및 레시피 도출 가능 - 후발업체가 획득시 여러 대체물질의 검증을 거치지 않고 최적물질 정보 획득 가능

[참고3] 사업장별 국가핵심기술 해당여부

구분	국가핵심기술	해당 보고서
기흥	- 30나노 이하급 파운드리에 해당되는 공정기술 - 모바일 Application Processor SoC 공정 기술	-`09~`17
화성	- 30나노 이하급 D램에 해당되는 공정기술 - 30나노 이하급 낸드플래시에 해당되는 공정기술 - 30나노 이하급 파운드리에 해당되는 공정기술	- `10~`17 - `09~`17 - `09~`17
평택	- 30나노 이하급 낸드플래시에 해당되는 공정기술	- `17
온양	- 30나노 이하급 D램에 해당되는 조립기술 - 30나노 이하급 낸드플래시에 해당되는 조립기술	- `11~`17 - `10~`17